



平成18年9月28日

各位

会社名 三益半導体工業株式会社
代表者名 取締役社長 中澤正幸
(コード番号 8155 東証第一部)
問合せ先 取締役 管理本部長 八高达郎
(TEL. 027-372-2011)

300mm シリコンウェハー加工設備の増強に関するお知らせ

当社は300mm シリコンウェハー加工設備の増強計画を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 加工設備増強の目的

当社は、シリコンウェハー最大手の信越化学工業株式会社からのウェハー加工受託と当社独自の再生ウェハー事業を両輪としてウェハー加工事業を展開してまいりました。

今後の300mm ウェハー需要の拡大に対応するため加工設備の段階的な増強を行うとともに、デバイスの微細化に対応する加工精度の向上と自動化による生産性の向上を図り事業の安定的な発展を期することといたしました。

2. 設備投資の概要

設備投資の内容	300mm ウェハー加工設備の増強
場所	当社上郊工場
所在地	群馬県高崎市保渡田町 2174 番地 1
投資額	約 250 億円
生産設備増強の時期	2007 年秋までに段階的に増強する

3. 今後の見通し

現時点で 2007 年 5 月期の業績予想に変更はございませんが、本増強計画の進捗状況により変更が生じる場合は速やかに開示する予定です。

以上